

技术参数

2125

日期：11/2020
上海禧合应用材料



应用介绍

特点

一款单组份紫外光固化胶黏剂，高触变，适用于电子领域元器件部件粘接固定，尤其使用于 LCP 及元器件粘接固定，具有较好的抗震耐湿热性能

粘接材料

塑料 LCP，玻璃，陶瓷等

典型应用

电子部件粘接固定

固化前特性

特征	数值	测试方法
化学名称	丙烯酸树脂	
颜色	无色液体	
粘度(cps)	4287	20rpm@25°C, ASTM D-1084
固化条件	1200mJ/cm ² @365nm	
有效期@ 25°C,月	6	

固化后特性

特征	数值	测试方法
外观	无色	
邵氏硬度	66D	ASTM D-2240
拉拔强度	30N	硅片+LCP
降解温度	320°C	
可靠性	数值	测试方法
固化失重	<1%	
工作温度范围	-55°C—120°C	

储存和使用方法

产品在常温环境中储存。避免阳光直射，建议在通风，阴凉干燥处密封保存；，使用胶水时应避免眼睛和皮肤接触，对于接触部位应及时使用肥皂和清水清洗。其他使用注意事项请参考 SDS 文件；

注：

本技术参数表所包含的参数是本产品最真实可靠的参数。对于其它机构测得的数据我们无法承担责任。客户最终决定本产品是否适用其工艺，对于生产过程中因使用不当产生的问题无法承担责任。我们建议客户正式使用前请做好各种测试工作。

